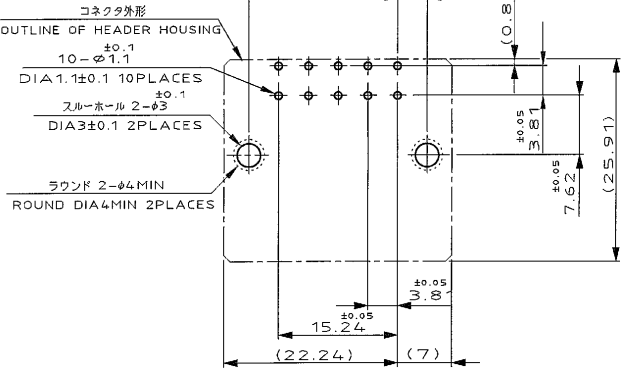
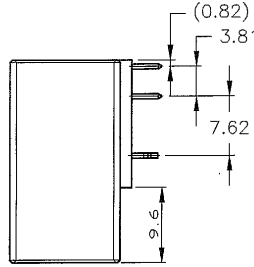
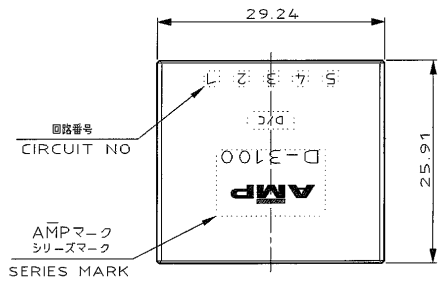


NUMBER 178305  
METRIC

PRINT DIST  
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

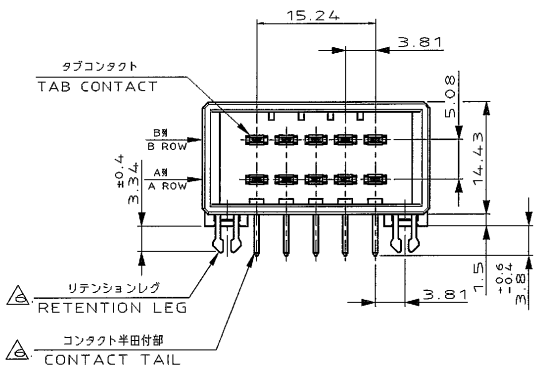


推奨基板取付け寸法

PC 基板厚: 1.6±0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)



NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
膜厚: 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
膜厚: 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
膜厚: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の土に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の土に半田めっき

△	△	178305-5
△	△	178305-3
△	△	178305-2
(FINISH)		部品番号 (PART NO.)

C	REVISED (PJ00-0039-03)	T S S M	4/2/92
B	REVISED (PJ00-0097-03)	T S S M	4/15/92
A	REVISED (PJ00-2183-95)	H K I S M	3/23/95
Q	RELEASED (J-1784)	N M	3-4/8.31/92
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK DATE

WIRE RANGE		INSULATION DIA	
MATERIAL		FINISH	
SEE NOTE		SEE NOTE	
注記参照		注記参照	
DR.	16 JUN 91	DE.	16 JUN 91
CHK.	M. M. & S. M. & P. P.	APP.	M. M. & S. M. & P. P.
	24/FEB/92		4/MAR/92
CHK.	71.0-0076	APP.	S. M. & P. P.

Copyright © 1991 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
NAME ダイナミック D3100 標準タイプ 10 極 ヘッダーアセンブリー					
10 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASSY FOR DYNAMIC 3100					
-公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE LDC NUMBER		C 178305	
100%	±0.3	A3	J		
30% & 100%	±0.4	SCALE		REV.	SHEET
30% & 100%	±0.5	2-1		C	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面